

株式会社リコー 2015年度(2016年入社)学校推薦求人票

求人票 No : R-165

■ 当社概要について

| | | | |
|-------|--|----------------|---|
| 名称 | 株式会社リコー | 従業員数 | 108,195名(連結)(2014年3月末時点) |
| 設立 | 1936年2月6日 | 事業内容 (主な製品) | 【画像&ソリューション分野】 デジタル複合機、コピー機、各種プリンター ITサービス、クラウド連携のネットワークアプライアンス ほか 【産業分野】 サーマルメディア ほか |
| 本社事業所 | 〒104-8222 東京都中央区銀座 8-13-1 | | |
| 代表者 | 代表取締役 会長執行役員 近藤 史朗 代表取締役 社長執行役員 三浦 善司 | | |
| 株式 | 一部上場 | 採用責任者 | 人事部 採用センター 所長 小谷 美樹 (コタニ ミキ) |
| 資本金 | 1,353億円(2014年3月31日現在) | 推薦状宛先 | * 推薦状は上記宛にて発行ください |
| 売上高 | 2兆1,956億円(連結)(2014年3月期) | | |

■ 募集要項について

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 給与 | 修士了: 240,300円/学部卒: 215,400円 (2014年4月初任給) | 勤務時間 | 9:00~17:30 標準労働時間(1日): 7時間30分 |
| 待遇 | 賞与: 年2回(7月・12月)/昇給: 年1回(4月) | 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、年間休日129日(一斉休暇含む)、祝日、有給休暇(半日、時間単位での取得可)、 フォーシーズン休暇、(春、夏、秋、冬連続休暇)、特別休暇、リフレッシュ休暇、MVP5(マイ・バケーション・プラン・ファイブ)休暇 他 |
| 諸手当 | 通勤手当(全額支給)、超過勤務手当、子女養育手当、出向手当、単身赴任手当 他 | | |

■ 本年度採用について

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 求人数 | 1人(修士・学士不問) | 募集対象 | 2016年4月入社: 2016年3月卒業・修了見込みの方 |
| 専攻分野 | 機械系、電気電子系、情報系、物理系、化学系、IE系 | 勤務地 | 全国事業所(海外含む) |
| 募集コース | 職種別 | リコーの学校推薦では、募集職種と学生さんの専門性・職業観をマッチングさせる目的で、ジョブマッチ方式を採用しております。ジョブマッチにご参加いただいた後、弊社よりマッチング完了連絡を差し上げた方にご応募いただきます。 * 本コースでは入社時の初期職種を決定するものとし、異動による職種変更の可能性があります。 * 職種を限定しない合格となる場合があります。 | <ul style="list-style-type: none"> 募集コース詳細につきましては、同封の「リコーの職種紹介」を必ずご確認ください。 弊社では、理系専攻の方の事務系職種への応募も歓迎しております。(事務系エントリーは自由応募のみ) |
| | 研究 設計開発 システムエンジニア 知的財産 その他技術職 (品質保証・生産技術など) | | |
| 求める人物像 | <p>リコーでは下記人材要件を有する方を強く求めています。</p> <ul style="list-style-type: none"> 物ごとをゼロベースで発想し、論理的に組み立てる思考力 実行に向けて一歩踏み出す行動力 実現に向けて周囲を巻き込み、最後までやり切る責任感・意欲 <p>上記のような行動を、学業、および学生生活の取り組みの中(論文投稿、国内外での学会発表、産官学との共同研究、海外留学などの学内外での活動)において、具体的に体现できていたと感じられる方を、ぜひご推薦くださいますよう、お願い申し上げます。</p> | | |

■ 学校推薦(ジョブマッチ)の実施要領について

| 実施時期 | 項目 | 実施内容 |
|------------|--------------------------|--|
| 3/1~ 随時 | 0. プレエントリー | 【Web】当社採用 HP よりメンバーズ登録をしてください。 * 3/1以降、登録可能となります。 |
| | 1. ジョブマッチ エントリー | 【Web】メンバーズページより、ジョブマッチエントリー(下記2点の実施)を行ってください。 1) 自己紹介シートの入力 * 希望職種・専攻分野等についてご入力ください。 2) 適性検査(テストセンター)の受検 * 受検科目は性格検査・言語・非言語・構造把握です。 |
| | 2. OB/OGによる コンサルテーション | OB/OGとの面談へご案内いたします。 * 今後のプロセスや募集職種に関するご説明などを行います。 * エントリー者多数の場合、書類選考を実施することがあります。 |
| | 3. ジョブマッチ相談 | 当社にて職種別のジョブマッチ相談会へご参加いただけます。 |
| 8/1~ | 4. 本エントリー | ジョブマッチ結果に基づき本エントリーいただく場合、推薦状の取得・応募書類の提出を行ってください。 * 本件実施以降の辞退はできません。 * 学内手続きや発行時期の関係上、推薦状・応募書類が直ぐに提出できない場合は推薦状の代わりに書類として紹介状などを提出し、後日正式な「推薦書」をご提出ください。 |
| | 5. 面接(1回) | 当社にて面接を受けて頂きます。(合否ご連絡は面接日より5営業日以内を目処とさせていただきます) * 合格・不合格に関わらず、メールにて大学様(就職ご担当者様等、エントリー時に入力頂く選考結果連絡先)にご連絡いたします。 |
| ご留意事項 | | <ul style="list-style-type: none"> 学校推薦と自由応募の同時併願は出来ません。 採用計画に達し次第、応募受付を締切らせて頂きますので、あらかじめご了承のほど、よろしくお願いたします。応募受付の締切については弊社採用 HP 内にてお知らせいたします。ご応募に際しては事前にご確認ください。 |

【本件お問い合わせ先】

株式会社リコー 人事部 採用センター 学校推薦係 電話: 03-6278-3140(直通) / E-mail: Zsaiyo.Z0365@nts.ricoh.co.jp

リコーの職種紹介

| 専攻 | 職種 | 専門性の応用領域 | 主な職務内容 | 求められる適性やスキルの目安 |
|-----|-----------|---|--|--|
| 情報系 | 研究開発 | ソフトウェア設計、ネットワーク・セキュリティ技術、画像・音声・映像認識/処理技術、メカ制御、計測・シミュレーション技術 | 新規領域・次世代の情報システムの提案、プロトタイプソフトウェア作成、情報基盤技術(特に画像・映像)の研究・開発、新規技術探索 | 世界初の情報システム・装置・モジュールを情報理論ばかりでなく人間の感性なども取り入れることでお客様に新しい価値を提案できる方。画像処理・認識を経験し、ソフトウェアプログラミングのスキルを有している方。 |
| | 設計開発 | (ソフト)、生産システム設計、データアナリティクス、データマイニング、情報処理技術、Web システム技術、光学センサ開発など | 組込系 ソリューションソフトの設計・開発(クラウド含む)、機器制御ソフトの開発、機器・装置のシミュレータの開発、アプリケーションソフトの開発、OS 開発、デバイスドライバ開発、機器上で動作するアプリケーション開発、ソリューションソフトの設計・開発(クラウド含む)光学センサーの開発、組込みシステムの開発 | 組込系 お客様視点で製品開発を進めることができる方。物・メカを高効率に動かす事に興味のある方。制御技術でモデルから実用化まで造り上げてみたい方。画像データを利用した解析・認識・高画質化・セキュリティに関心のある方。新しいオフィス環境の提案ができる発想力を持っている方。お客様視点で製品開発を進めることができる方。情報工学専攻、ロジック回路の設計経験のある方。 |
| | システムエンジニア | | アプリ開発 ソリューションソフトの設計・開発(クラウド含む) PC やタブレットで動作するアプリケーション開発、ビッグデータ解析技術の開発、新しいネットワークシステムの開発、新しいWebシステムの開発、データを統合管理するシステム機構の開発、高感度磁気センサー開発 | アプリ開発 海外技術者と連携したグローバル開発に興味のある方。お客様視点で製品開発を進めることができる方。新しいオフィス環境の提案ができる発想力を持っている方。ビッグデータ解析、情報分析に興味があり、その応用システムの開発や新規ビジネスの立ち上げに意欲のある方。IoT分野(通信、センシング、データ解析など)において先端的な研究開発をやりたい方。ソフトウェアやネットワーク開発の経験、Bluetooth,NFC,Wi-Fi などの制御や関連ソフトウェア、SDN,CNN などのネットワークシステムの研究などの経験がある方。通信規格等の英文規格書を読み解くレベルの語学力のある方。C/C++言語のプログラミング経験のある方。自律性、チャレンジ精神、協調性がある方。映像伝送・配信の研究経験のある方。DBMS・クラウド関連技術のスキルを有する方。 |
| | | | お客様の課題分析からソリューション提案、要件定義(SE など)、システム構築・導入に関連したプロジェクトマネジメント | 情報技術者試験(基本・応用)に合格、または同等レベルの実力をお持ちの方。最先端のソフトウェア技術に興味があり、それを充分使いこなせる方。お客様の課題に親身になって相談にのり解決していくことができる方。グローバルな仕事に興味のある方。 |
| 機械系 | 研究開発 | 機械設計(機構設計、部品設計、筐体設計など)、金型・治具設定、加工・成型技術、メカ制御、計測・評価解析技術・機構系シミュレーション技術、プラント設計、設備設計(精密加工装置設計、精密組立装置設計など)、軌跡制御、アクチュエータ選定、パワーウェイト計算、3D 設計技術、構造・熱解析技術を活用した統合設計、レーザーモジュール開発など | 新規領域・次世代の製品・機構・制御の提案 プロトタイプの機構・外装設計・作成、製品の問題解析と根本的な解決、新しい自動化設備、自動化システムに対応したメカ設計、レーザーモジュールのメカ開発や光学開発 | 幅広い科学・技術知識があり、多様な技術分野と機械工学を結合した新技術を自ら生み出そうと行動できる方。材料、制御、機構学、システム統計論、入出力系のセンサおよびアクチュエータ選定に携わっていた経験のある方。ゼロからシステムを作り上げた経験のある方。境界領域の開発ツールの提供により、開発プロセスのイノベーションに貢献したい方。深いメカニズムの理解に基づく新方式・跳躍的技術を提案できる方。 |
| | 設計開発 | | 製品の機構・外装設計、製造装置/生産設備(ロボット化)・プラントの設計・生産工程設計、製品・製造工程の問題解析と改善微細な構造に対する機能性評価、設計・開発過程における問題解析(メカニズム解明と改善策の提示)と検証 | 現商品搭載技術ばかりでなくロボットのような最先端機械技術にも興味があり、お客様のご要望を聞きながら製品開発を進めていくことに喜びを感じることができる方。現象を直接見ることを諦めず粘り強く、かつ精細に実践できる方。 |

| 専攻 | 職種 | 専門性の応用領域 | 主な職務内容 | 求められる適性やスキルの目安 |
|-------|------|--|---|--|
| 電気電子系 | 研究開発 | デジタル・アナログ回路設計、実装設計、半導体デバイス設計、LSI設計、MEMSデバイス設計(インクジェットヘッドなど)、メカ制御、計測・シミュレーション(エレキ)、プラント設計、マイコン、モータ制御、安全回路等を含めた自動化設備系の電気技術、レーザー開発など | 新規技術探索、機能の高速化・高精度化・低コスト化の技術・アルゴリズム開発、新規領域・次世代の製品・回路・LSIの提案、プロトタイプ回路設計・作成、製品の問題解析と抜本的な解決、新しい自動化設備、自動化システムに対応した電気回路設計、新規レーザー技術開発 | メカ・エレキ・ソフトの分野を問わずアイデアの具現化に強くこだわりを持って取り組める方。MEMSやソフトウェアに関する知識もあればなお良い。世界初のデバイス・モジュールの開発、計測、シミュレーションにチャレンジしたい方。弱電、強電、アナログ、デジタルを広く経験した方。ゼロからシステムを作り上げた経験のある方。 |
| | 設計開発 | | デバイス開発・設計(ASIC/センサー)、製品・ツールの回路設計・実装設計、製造装置/生産設備(省エネ化)・プラントの設計・生産工程設計、製品・製造工程の問題解析と改善、システム・デバイス製品の提案、システム・デバイスのプロトタイプ設計・作成、新規システムの商品化、インクジェットヘッドの駆動モジュールの設計、ヘッド駆動制御設計、機能・アルゴリズムの実用化設計、オフィス内外・機器内外のセンシングの開発設計、機能・性能の測定装置の開発設計、機能の高速化・高精度化・低コスト化の技術・アルゴリズム開発 | 電子デバイス・PCBの設計(アナログ、デジタル)、システム設計の基本知識を持ち、制約のある中で粘り強く問題を解決しながら一つの製品に仕上げていける方。また、生産の省エネルギーに関心のある方。専門枠にとらわれることなくチャレンジできる方。ネットワーク技術もしくは画像系技術のバックグラウンドがあり、コンピューターシステム(システム LSI 含む)について基礎知識がある方。ドライブすべきデバイス特性を最大限に発揮させるために、技術の融合や新規技術の導入し新たな可能性を提案できる方。物・メカを動かす事に関心がある方。画像処理をアルゴリズムから ASIC、さらに実用化し製品まで造り上げてみたい方。画像データを利用した解析・認識・高画質化・セキュリティに関心のある方。 |
| 物理系 | 研究開発 | 基本構成・動作設計(電子写真プロセス・インクジェット)、半導体製造プロセス設計、インクジェットヘッド設計、物性解析技術、光学設計技術、分析・計測・シミュレーション技術(物理・光学)、画像工学、モジュール技術開発、光学センサ開発、光学評価、材料合成および評価など | 新規領域・次世代の製品基本構成・動作の提案、半導体などの新規製造プロセスの提案、光学系プロトタイプ設計・作成、プロトタイプによる動作原理の実証、技術系を支える実験・計測技術、およびシミュレーション技術の開発、新規センシングデバイス開発、VCSELデバイスの開発業務、光学デバイス開発(材料、デバイス系)、光学モジュールの研究開発、微細光学素子の研究開発、熱電材料の材料設計、材料合成及び特性の評価 | 物理学や光学分野に長け、あらゆる知識を駆使し、次世代の商品・設備のキーとなる主要プロセスを提案できる方。また、不具合現象を原理原則で解明するため、可視化・計測、シミュレーションなどを使いこなせる方。光エレクトロニクス、フォトリソグラフィの研究経験のある方。クリーンルームでのデバイス製作経験のある方。 |
| | 設計開発 | | 製品の構成・動作の全体システム設計、物理モデルによるシミュレーション、半導体などの製造プロセスの実用化、光学系の最適設計、製品・生産工程の問題解析と改善、光・レーザー応用技術の開発 | システム設計側から各要素技術へ目標値を設定するだけの周辺知識を習得し、リーダーシップを発揮できる方。また、これら目標値をお客様視点で設定できる方。シミュレーションのための物理モデルを作るに十分な専門性を習得できる方。見えない(見づらい)現象を可視化する技術・ツール開発に興味がある方。さまざま事象に対して論理的な解析にチャレンジしたいと思う方。 |
| 化学系 | 研究開発 | 耐薬品性材料開発(接着剤、撥水膜、下地膜など)、機能性材料(圧電材料)、無機材料・有機材料・分析技術を用いた記録材料(インク・トナーなど)、機能部材(ローラ・ベルトなど)、環境・エネルギー・積層造形用材料などの研究開発、材料合成、材料物性研究、処方設計、材料分析、生産技術、IR/NMRを中心とした有機分析、化学反応機構設計、材料開発および評価など | 新規領域・次世代の化成品商品の研究と提案、性能を飛躍的に向上させるサプライ並びにその材料の提案、製品・製造工程の問題解析と抜本的改善、材料加工プロセスの開発、化学蓄熱材を活用したシステムの反応機構開発、弾性圧電体の材料開発および評価 | 化学ばかりでなく、幅広い分野の科学・技術に興味があり、自ら何かを生み出そうと行動できる方。原理原則に基づき病理現象を化学で解明するための十分な専門性を取得できる方。化学工学の知識を有する方、材料(化学、物理、電気)の知識を有し、新たな価値を創造することに意欲的な方。 |
| | 設計開発 | | 化成品商品の構造設計・分析・評価、サプライ製品の製造方法確立・プラント設計、製品・製造工程の問題解析と改善、インクジェットに使われるインクに対し耐性の優れた機能性材料の開発 | 化学ベースの知識だけではなく、製品化への応用展開と最終的な工業化(プラント設計など)も意識して開発/改良に取り組める方。化学工学・品質工学などの幅広い知見と興味を持ち、技術開発のみでなく工法設計までの広範囲な開発ができる方。 |
| 知的財産 | | ソフトウェア、電気、電子工学、化学などの技術的専門知識と知財財産に関する法律知識を用いた知的財産の取得、活用 | 日本、米国、欧州および新興国を主とした知的財産(特許、意匠など)の取得と活用、他社特許への対応、知的財産についての戦略立案、模倣品対策、ライセンス交渉、技術関連契約作成を含む知財法務業務 | 知的財産に興味があり、企業の競争優位を知財で実現するという意欲のある方。また、新しい技術に興味をもち、開発区とのコミュニケーションにも積極的に取り組める方。TOEIC600点以上が望ましい(海外の法律事務所や関連会社への駐在制度あり)。 |
| 全専攻対象 | | | その他技術職(品質保証・生産技術など) | |